



# 株式会社UKCホールディングス

## 2011年3月期 第1四半期決算説明資料

---

2010年8月13日



株式会社 UKCホールディングス

---





# 目次

事業セグメント	4
2011年3月期 第1四半期 決算概要	
2011年3月期第1四半期決算ハイライト	6
セグメント情報 半導体及び電子部品事業	7
セグメント情報 電子機器事業	8
セグメント情報 システム機器事業	9
財政状態 バランスシート	10
財政状態 キャッシュ・フロー	11
2011年3月期 業績予想	13
トピックス	15





# 事業セグメント



# 事業セグメント



事業部門（セグメント）		主要製品
半導体及び電子部品事業	半導体	イメージセンサー、メモリー、マイコン、システムLSI、その他半導体
	電子部品・その他	液晶パネル、バッテリー、光学ピックアップ、ACF※、基板、複合部品、その他一般電子部品、EMS
電子機器事業	電子機器	各種VTR、カメラ、ビデオプリンター、音響映像関連機器
	記録媒体品	磁気テープ、光ディスク、データ記録用ディスク
	製品	電子機器を組み合わせたシステム製品、セキュリティ関連製品
	その他	電子機器の修理、AV機器のレンタル、教育用ソフトウェア
システム機器事業	産業電子機器及び伝送端末機器	非接触ICカード（FeliCa）R/Wモジュール、リモコン電子キーシステム、医療用監視システム、セキュリティシステム
	その他	品質検査受託業務、分析受託業務

※ 異方性導電膜（Anisotropic Conductive Film）

・・・中・小型液晶パネルとフレキシブルプリント基板を接合するフィルム型の実装材料



---

# 2011年3月期 第1四半期 決算概要



# 2011年3月期 第1四半期 決算ハイライト



(単位：百万円)	2010年3月期1Q<参考> (USC1Q+KTS1Q単純合算)		2011年3月期1Q		前年同期比<参考>	
	金額	構成	金額	構成	増減金額	増減率
売上高	58,627		71,985		+13,357	+22.8%
売上総利益	3,417	5.8%	4,070	5.7%	+652	+19.1%
SGA	2,949	5.0%	2,928	4.1%	▲20	▲0.7%
営業利益	468	0.8%	1,141	1.6%	+673	+143.8%
経常利益	319	0.5%	1,085	1.5%	+765	+239.4%
当期純利益	▲34	-	611	0.8%	+645	-

※当社は、2010年10月1日付でユーエスシー(USC)と共信テクノソニック(KTS)との経営統合に伴い、両社の共同持株会社として設立  
前第1四半期連結会計期間(2009年4月1日から2009年6月30日)の連結経営成績はUSC及びKTSの単純合算にて算出(参考値)

- 高級デジタルスチルカメラ、携帯電話、薄型テレビ等のデジタル家電関連の旺盛な需要に支えられ、主力事業である半導体及び電子部品の販売が好調に推移
- 売上総利益も売上高拡大に合わせて伸長し、ほぼ前年同期並みのSGAと合わせ、営業利益は前年同期の約2.5倍となった
- 主に、為替差損の減少により営業外損益が改善。また、前年同期に計上していた早期退職関連費用がなくなったことで特別損益も改善し、当期純利益は前年同期の赤字から6億円超の黒字となった



# セグメント情報 半導体及び電子部品事業

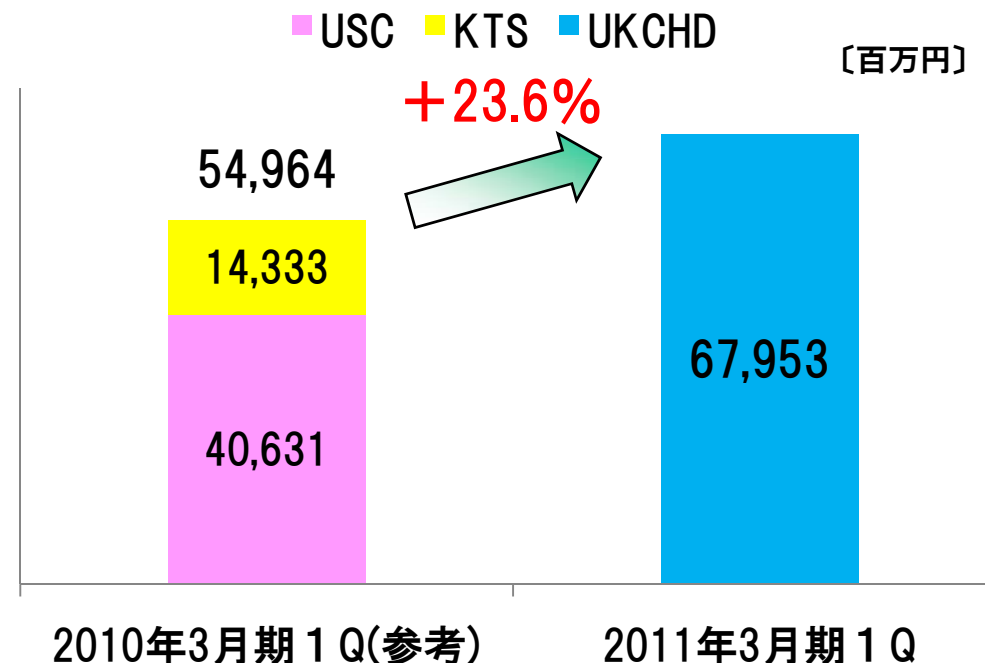


## 売上高

679.5億円

前年同期比(参考)

+129.9億円



- 消費者購買意欲の回復に牽引され、高級デジタルスチルカメラやスマートフォン市場が活性化。当社事業もイメージセンサーを中心に販売好調
- デジタル家電向けの旺盛な需要に支えられ、薄型テレビ向けサムスン電子製液晶パネルやBlu-ray向け光学ピックアップ等が伸長
- 環境関連(薄型TV向けLED)事業も2Qから本格化



# セグメント情報 電子機器事業



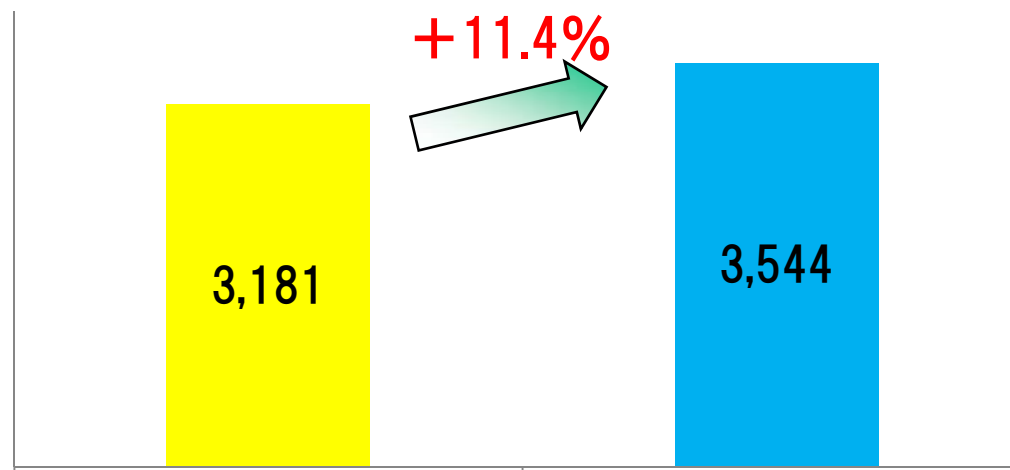
## 売上高

35.4億円

前年同期比(参考)

+3.6億円

■ KTS ■ UKCHD [百万円]



2010年3月期1Q

2011年3月期1Q

※10年3月期1Qには、10年3月期3Qより連結対象から除外した  
平成堂の売上高97百万円を含む

- 顧客の設備投資は回復傾向にあり、当社事業の販売も概ね計画通りに推移
- 3D関連ビジネスが、プロダクション向け撮影用カメラや編集システムを中心に本格始動。メディカル用途やブライダル用途といった新規需要もあり、市場は拡大傾向
- イメージセンシングビジネスは、韓国でマシンビジョンが継続的に伸長  
国内においても半導体装置メーカー向けを中心に市場が回復





# セグメント情報 システム機器事業

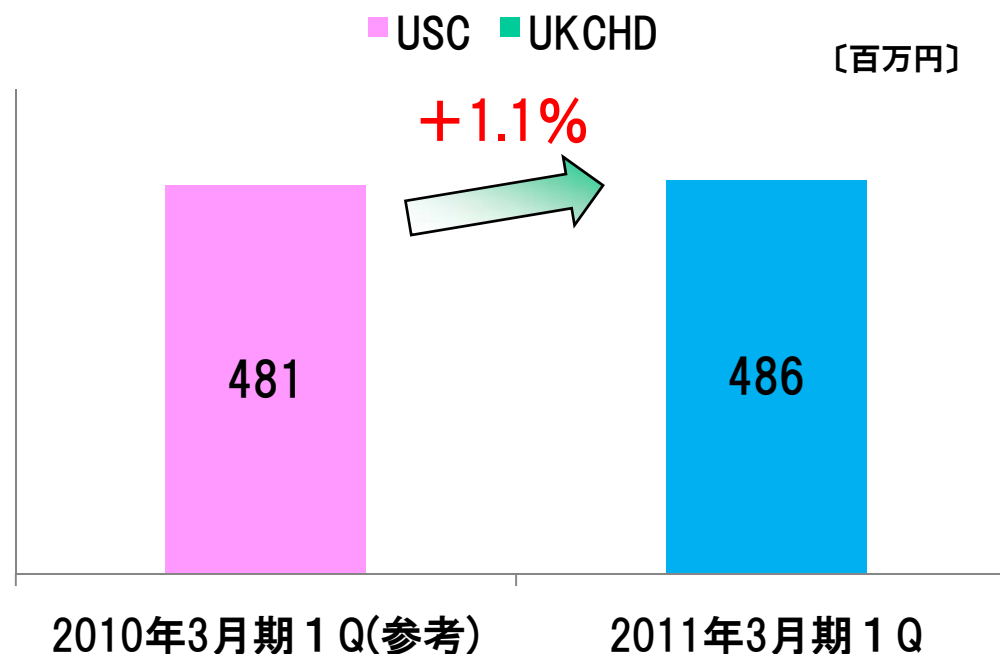


## 売上高

4.9億円

前年同期比(参考)

+5百万円



- 非接触 IC カード(F e l i C a)関連事業では、電子マネー、セキュリティー、デジタルサイネージ市場の一部が回復基調。しかしパソコン市場における低価格帯へのシフトは続き、F e l i C a モジュール搭載には慎重な傾向
- 半導体及び電子部品の信頼性試験・環境物質分析サービスでは、試験数、新規案件が増加傾向



# 財政状態 バランスシート

(単位：百万円)		10/3月末	10/6月末	増減
	現預金	11,668	11,977	308
	売上債権	63,016	70,900	7,884
	棚卸資産	13,262	14,673	1,410
	その他	2,751	2,799	48
流動資産計		90,698	100,351	9,652
固定資産計		4,907	4,645	▲261
総資産		95,606	104,996	9,390
	仕入債務	42,499	44,797	2,298
	短期借入金	9,496	17,334	7,837
	その他	6,015	6,361	345
流動負債計		58,011	68,493	10,481
	長期借入金	888	105	▲782
	その他	1,047	1,087	40
固定負債計		1,936	1,193	▲742
純資産		35,658	35,309	▲348
自己資本比率		36.1%	32.6%	-3.5%

- 取引高の増加に伴い、売上債権、仕入債権及び棚卸資産が増加したことで、総資産が1,050.0億円、負債が696.9億円となった
- 純資産は、資本剰余金からの配当と評価換算差額等の変動により、前連結会計年度から3.5億円減少し、353.1億円となった
- 自己資本は342.0億円、自己資本比率は32.6%となった

# 財政状態 キャッシュ・フロー



## □営業活動によるキャッシュ・フロー **△58.4億円**

主に、税金等調整前四半期純利益10.3億円及び仕入債務の増加36.8億円に対して、売上債権の増加が83.6億円、たな卸資産の増加が16.0億円及び法人税等の支払額が5.5億円であったことによる

## □投資活動によるキャッシュ・フロー **2.0億円**

主に、定期預金の払戻による収入9.2億円に対して、定期預金の預入による支出が5.1億円及びその他の支出が1.7億円であったことによる

## □財務活動によるキャッシュ・フロー **65.7億円**

主に、短期借入金の純増72.0億円に対して、配当金の支払が4.8億円及び長期借入金の返済による支出が1.1億円であったことによる

## □現金及び現金同等物 **109.2億円**





---

# 2011年3月期 業績予想



# 2011年3月期業績予想

(単位：百万円)	2010年3月期 上期実績<参考> (USC1H+KTS1H単純合算)		2011年3月期 上期業績予想				増減率	前年同期比 <参考>	通期予想
			2010/5/14公表		2010/8/13修正				2010/5/14公表
	金額 ①	構成	金額 ②	構成	金額 ③	構成	③/②	③/①	金額
売上高	123,032		135,000		148,000		+9.6%	+20.3%	280,000
売上総利益	7,397	6.0%	7,200	5.3%	8,100	5.5%	+12.5%	+9.5%	14,500
SGA	5,885	4.8%	5,700	4.2%	6,100	4.1%	+7.0%	+3.6%	11,400
営業利益	1,512	1.2%	1,500	1.1%	2,000	1.4%	+33.3%	+32.3%	3,100
経常利益	884	0.7%	1,480	1.1%	1,900	1.3%	+28.4%	+114.8%	3,000
当期純利益	253	0.2%	920	0.7%	1,200	0.8%	+30.4%	+373.7%	1,750

- 上半期業績はデジタル家電等の好調な需要に支えられ、当初予想を上回る見込み
- SGAは、売上(物流量)増や半導体・電子部品の需給逼迫に伴うデリバリー対応による物流費増加、本社オフィス移転に伴う費用が当初見積もりを上回ったこと等により増加
- SGA増、円高進行に伴う為替差損の発生による営業外損益の悪化を売上総利益の増加がカバーし、経常利益も増加
- 通期の業績予想については、現在、第3四半期以降の市場動向や経営環境を精査中であるため、現時点では従来予想を据え置く



# トピックス



# トピックス

- **EMS (Electronic Manufacturing Service) 事業強化**
  - ・ 日本ケミコンとの合弁会社CU TECH CORPORATIONの中国における新会社である東莞新優電子有限公司への設備導入は完了。9月から本格的な生産を開始
  - ・ 10月には日本ケミコンが所有するCU TECH CORPORATIONの出資持分の一部を当社が譲り受け、CU TECH CORPORATIONを当社の連結子会社化(持分70%)
- **拠点統合**

本社（ホールディングス、USC・KTS両本社）拠点統合及び物流拠点集約は8月16日完了予定（計画通り）
- **グループ会社再編**

シンガポール地区の統合を2010年10月、香港地区の統合を2011年1月に予定



株式会社 UKCホールディングス

〈お問い合わせ先〉

経営企画部 大澤

Mail to : [ir@ukcgroup.com](mailto:ir@ukcgroup.com)

本プレゼンテーション資料中のデータや将来予測は、資料作成時点における当社の判断や入手可能なデータに基づくもので、今後様々な要因によって変化することがあり、その情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。